PAT-NO:

JP02000122071A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2000122071 A

TITLE:

LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND

COUNTRY

COUNTRY

N/A

N/A

N/A

N/A

PRODUCTION OF LIQUID

CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

PUBN-DATE:

April 28, 2000

INVENTOR - INFORMATION:

NAME YAMADA, YUKA YAMAMOTO, TAKESHI NINOMIYA, KISAKO KURAUCHI, SHOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP10290732

APPL-DATE:

October 13, 1998

INT-CL (IPC): G02F001/1339, G09F009/30

### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent generation of film thickness irregularity around pillar like spacers formed when part of a wet coating film applied on a substrate after formation of pillar-like spacers flows down to the pillar base.

SOLUTION: On a contact hole 56 formed in a color filter layer 52 of an array substrate 30, a pillar-like spacer 70 having a greater radius than that of the

contact hole 56 is pattern-formed using a black colored resin, and a depression is formed on the pillar top 70a. In this way, a polyimide solvent 71 coated on the top 70a of the pillar-like spacer 70 remains held in the depression without flowing down to the base of the pillar like spacer 70, irregularity of the film thickness around the pillar-like spacer 70 can be dissolved and an excellent liq. crystal display element is obtained.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-122071 (P2000-122071A)

(43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)

(51) Int.CL."		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G02F	1/1339	500	G 0 2 F	1/1339	500	2H089
G09F	9/30	3 2 4	G09F	9/30	3 2 4	5 C O 9 4

#### 窓舎請求 未請求 請求項の数6 〇1、(全11 頁)

		<b>潜性耐</b> 状	未耐水 耐水坝の数6 〇L(全 11 貝)		
(21)出願番号	<b>特顯平10-290732</b>	(71)出顧人	000003078		
			株式会社東芝		
(22)出顧日	平成10年10月13日(1998.10.13)	神奈川県川崎市幸区場川町72番地			
		(72)発明者	山田 由夏		
			埼玉県深谷市幡温町一丁目9番2号 株式		
			会社東芝深谷電子工場内		
		(72)発明者	山本 武志		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番2号 株式		
			会社東芝深谷電子工場内		
		(74)代理人	100081732		
			弁理士 大胡 典夫 (外1名)		
			最終質に続く		

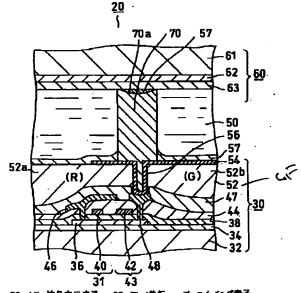
#### 最終貝に続く

## (54) 【発明の名称】 被晶表示素子及び被晶表示素子の製造方法

# (57)【要約】

を塗布した時に、柱状スペーサ表面の被膜がその裾野に流れ柱状スペーサ周辺で膜厚むらを生るのを防止する。 【解決手段】 アレイ基板30のカラーフィルタ層52に形成されるコンタクトホール56の上方に、黒色樹脂にてコンタクトホール56より径の大きい柱状スペーサ70をパターン形成し、その頂上70aに窪みを形成する。これにより柱状スペーサ70頂上70aに塗布されたポリイミド溶剤71は柱状スペーサ70周辺に流れる事無く窪みに溜りそこにとどまるので、柱状スペーサ70周辺の膜厚むらを解消出来、良好な表示の液晶表示素子を得られる。

【課題】 柱状スペーサが形成された上から基板に被膜



20:カラー液晶表示素子 30:アレイ基板 31:スイッチング素子 36:半導体層 47:局別絶最版 48:エンタクト電枢 50:液晶組成物 52:カラーフィルタ屋 54:画章電紙 56:エンタクトホール 57,63:配肩膜 60:対向基板

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入 して成る液晶表示素子において、前記基板の少なくとも 何れか一方に設けられ頂上に窪みを有し前記間隙を一定 に保持する柱状スペーサと、この柱状スペーサ形成後前 記基板に塗布される被膜とを具備することを特徴とする 液晶表示素子。

【請求項2】 2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入 してなる液晶表示素子の製造方法において、前記基板の 少なくとも何れか一方の表面に凹部を形成する工程と、 前記凹部上に前記凹部を覆うよう前記凹部の面積より広 い断面積を有し前記間隙を一定に保持する柱状スペーサ を形成することにより前記柱状スペーサ頂上に窪みを形 成する工程と、前記柱状スペーサ形成後前記基板に被膜 を塗布する工程とを具備することを特徴とする液晶表示 素子の製造方法。

2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入 【請求項3】 してなる液晶表示素子の製造方法において、前記基板の 少なくとも何れか一方に前記間隙を一定に保持する柱状 スペーサを形成する工程と、前記柱状スペーサ頂上を削 ることにより前記柱状スペーサ頂上に窪みを形成する工 程と、前記窪み形成後前記基板に被膜を塗布する工程と を具備することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。 【請求項4】 2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入 して成る液晶表示素子において、前記基板の少なくとも 何れか一方に設けられ前記間隙を一定に保持する柱状ス ペーサと、前記基板の前記柱状スペーサ周囲に設けられ る溝と、前記柱状スペーサ上から前記基板に塗布される 被膜とを具備することを特徴とする液晶表示素子。

【請求項5】 2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入 30 してなる液晶表示素子の製造方法において、前記基板の 少なくとも何れか一方の表面に凹部を形成する工程と、 前記凹部内に前記凹部の面積より狭い断面積を有し前記 間隙を一定に保持する柱状スペーサを形成することによ り前記柱状スペーサ周囲に溝を形成する工程と、前記柱 状スペーサ形成後前記基板に被膜を塗布する工程とを具 備することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項6】 2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入 してなる液晶表示素子の製造方法において、前記基板の 少なくとも何れか一方に前記間隙を一定に保持する柱状 40 スペーサを形成する工程と、前記柱状スペーサより上層 の構成層を前記柱状スペーサ周囲に溝を形成するようパ ターン形成する工程と、前記上層の構成層をパターン形 成後前記基板に被膜を塗布する工程とを具備することを 特徴とする液晶表示素子の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板間に液晶組成 物を保持して成る液晶表示素子において、柱状スペーサ を用いて基板間の間隙を一定に保持する液晶表示素子及 50 は、柱状スペーサ表面に保護膜を被膜後配向膜を被膜す

び液晶表示素子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピューター等情報機器分野及 びテレビ等の映像機器分野において、薄型軽量且つ高精 細な液晶表示素子が開発されている。現在、一般に用い られている液晶表示素子の多くは、電極を有する2枚の ガラス基板と、その間隙に封入された液晶組成物から構 成されている。具体的には例えばカラー型アクティブマ トリクス型液晶表示素子においては、第1の基板である アレイ基板上にアモルフアスシリコン等を半導体層とし た薄膜トランジスタとそれに接続された画素電極と信号 線電極、ゲート電極、三原色の着色層からなるカラーフ ィルタ等が形成されている。一方第2の基板である対向 基板上には対向電極が形成されている。 そしてアレイ基 板と対向基板とを、スペーサにより一定の間隙を保持し て対向配置し、接着剤に囲繞される両基板の間隙に液晶 組成物を封入して成っている。

【0003】この両基板の間隙を一定に保持するスペー サとしては、基板に均一に散布して用いる粒径の均一な プラスチックビーズに代わり、近年では基板上に直接パ ターン形成して成るスペーサが開発され、代表的な例と しては、カラーフィルタや遮光層形成時に、これらと同 一材料で同一タイミングにてパターン形成してなる柱状 スペーサが多用されている。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記基板に形成される 柱状スペーサにより、2枚の基板間の間隙を均一に保持 して成る液晶表示素子は、その製造工程において、基板 形成後に、柱状スペーサの上から、ポリイミド溶液から なる配向膜材料を塗布して配向膜を得ている。しかしな がら図17(a)に示すように柱状スペーサ10を有す る基板11表面にポリイミド溶液12を均一に塗布して も、基板11表面に段差があることから、乾燥する間の 時間の経過に従いポリイミド溶液12は全体を平坦化し ようとする表面張力によって柱状スペーサ10の表面部 分に塗布されたものが下に引っ張られ、 図17 (b) に 示すように柱状スペーサ10の裾野に流れてしまう。 こ のため乾燥後に焼成しても、図17(c)に示すように 配向膜13は、柱状スペーサ10の麓から周辺にかけて 緩やかな膜厚ムラを生じてしまっていた。そして配向膜 に膜厚ムラを生じた基板を用い液晶表示素子を形成した 場合、柱状スペーサ周辺に干渉稿等の表示ムラを生じ、 表示不良を起こすという問題を有していた。

【0005】更に、基板にカラーフィルタや遮光層のよ うな感光性樹脂からなる柱状スペーサを形成後その上に 直接配向膜を塗布した場合、感光性樹脂中に含まれる不 **純物成分が配向膜上に吸着してしまい、表示むらや焼き** 付きによる表示不良を発生することが懸念されことか ら、感光性樹脂により柱状スペーサを形成する場合に

るものも開発されている。しかしながらこのように柱状スペーサ形成後に基板表面に保護膜であるオーバーコート層を介し配向膜を塗布すると、柱状スペーサの裾野にはオーバーコート剤とポリイミド溶液とが流れ落ち、焼成後オーバーコート層と配向膜とが共に柱状スペーサ周辺で膜厚ムラを生じ表示ムラによる表示不良を起こすという問題を有していた。

【0006】そこで本発明は上記課題を除去するもので、柱状スペーサ形成後の基板表面への被膜溶剤塗布時に、被膜溶剤が柱状スペーサの裾野に流れ出すのを防止 10 し、焼成後膜厚ムラを生じる事無く良好な表示を得る事が出来る液晶表示素子及び液晶表示素子の製造方法を提供する事を目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決する為の手段として、2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入して成る液晶表示素子において、前記基板の少なくとも何れか一方に設けられ頂上に窪みを有し前記間隙を一定に保持する柱状スペーサと、この柱状スペーサ形成後前記基板に塗布される被膜とを設けるものである。【0008】これにより本発明は、柱状スペーサ頂上に塗布された被膜を柱状スペーサ頂上の窪みに溜めて柱状スペーサの裾野に被膜が流れるのを防止し、被膜の膜厚の均一かを図り表示品位を向上するものである。

【0009】又本発明は上記課題を解決する為の手段として、2枚の基板間の間隙に液晶組成物を封入して成る液晶表示素子において、前記基板の少なくとも何れか一方に設けられ前記間隙を一定に保持する柱状スペーサと、前記基板の前記柱状スペーサ周囲に設けられる溝と、前記柱状スペーサ上から前記基板に塗布される被膜 30とを設けるものである。

【0010】これにより本発明は、柱状スペーサ頂上に 塗布後柱状スペーサ表面から液垂れした被膜を柱状スペーサ周囲の溝に溜めて柱状スペーサの裾野に被膜が流れ るのを防止し、被膜の膜厚の均一かを図り表示品位を向 上するものである。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の第1の実施の形態を図1及び図2を参照して説明する。図1は本発明によるカラー液晶表示素子20の主要部を表す概略断面図である。同図に示したカラー液晶表示素子20は、いわゆる透過型の液晶表示素子であり、アレイ基板30とそれに対向して配置された対向基板60とこれらの間に封入された液晶組成物50とを備える。アレイ基板30には、複数のスイッチング素子31が形成され、その表面には被膜であるポリイミドからなる配向膜57が塗布されている。また対向基板60は、ガラス基板61の主面上に共通電極62と配向膜63が形成された構成を有する。対向基板60とアレイ基板30は黒色樹脂からなる柱状スペーサ70によって基板間の距離を一定に保持さ50

れている。

【0012】アレイ基板30は、ガラス基板32上にアンダー・コート層34を介して、チャネル層を挟みソース領域・ドレイン領域が形成されるポリシリコン(以下p-Siと称する。)からなる半導体層36が設けられている。半導体層36上にはゲート絶縁層38を介しゲート電極40と補助容量線42がパターン形成され、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor; TFT)からなるスイッチング素子31とコンデンサ43とを構成している。更に絶縁層44を介し、ドレイン領域に接続される信号線46、ソース領域に接続されるコンタクト電極48が設けられている。

【0013】これらの上方には層間絶縁層47が設けられ、更に有機樹脂絶縁膜からなる赤(R)、緑(G)、青(B)の3原色の着色層52a、52bがストライプ状にパターン形成されて成るカラーフィルタ層52が設けられ、着色層52a、52b上にはインジウム錫酸化物(以下ITOと略称する。)からなる画素電極54が形成され、凹部であるコンタクトホール56を介してコンタクト電極48に接続されている。コンタクトホール56上にはアレイ基板30及び対向基板60間の間隙を一定に保持する柱状スペーサ70が設けられるが、この柱状スペーサ70の頂上70aには窪みが形成されている。

【0014】次に液晶表示素子の製造方法について述べる。まずガラス基板32上にアンダー・コート層34を堆積し、プラズマCVD法によりアモルファス・シリコン(a-Si)膜を堆積する。続いてレーザ・アニール法によりアモルファス・シリコン膜を結晶化させてpーSi膜36を形成する。このp-Si膜36を所定の形状にパターン形成しゲート絶縁層38を堆積後、スパッタリングにより膜厚約0.3μmのモリブデン(Mo)からなる金属膜を成膜し、パターン形成してゲート電極40及び補助容量電極42を形成する。次にこれらの電極40、42をマスクにしてイオン注入法によりポリシリコン膜36に不純物を注入する。

【0015】更に絶縁層44を堆積しコンタクト・ホールを形成後、アルミニウム(A1)とモリブデン(Mo)との積層膜を堆積し、パターン形成により信号線46及びコンタクト電極48を形成する。以上に説明した一連のプロセスは、当業者の間で「トップゲート構造」と称されるポリシリコンTFTの形成条件に準ずることができる。

【0016】この後プラズマCVD法により窒化シリコン(SiNx)を500nm堆積し層間絶縁層47を形成する。次にフォトレジストマスク(図示せず)をパターン形成し、CDE法により層間絶縁層47をエッチングして直径5μmのコンタクトホール56を形成する。 続いて赤色の顔料を分散させた感光性レジストCR-2000(富士ハントテクノロジ(株)製)をスピンナー

20

にて全面塗布し、90℃、10分の乾燥後、赤色の着色層を形成する部分のみに紫外線を照射し、コンタクトホール56エリアを遮光するフォトマスクを介し、露光量が200mJ/cm²となるように露光を行う。次に水酸化カリウム(KOH)1wt%水溶液で20秒間現像を行い、200℃で60分焼成して直径6μmのコンタクトホール56を有する赤色の着色層52aを形成する

【0017】同様にフォトリソグラフィ技術により緑色(G)の顔料を分散させた感光性レジストCG-2000(富士ハントテクノロジ(株)製)及び青色(B)の顔料を分散させた感光性レジストCB-2000(富士ハントテクノロジ(株)製)を必要部分に配置し、赤、緑、青の着色層52a、52bを設け、直径6μmのコンタクトホール56を有するカラーフィルタ層52を形成する。その後カラーフィルタ層52上にスパッタリングによりITOを膜厚約0.1μm成膜し、フォトリソグラフィにより所定の形状にパターン形成してコンタクトホール56を介しコンタクト電極48と接続する画素電極54を形成する。

【0018】更に、感光性の黒色樹脂をスピンナーを用いて塗布し、90℃、10分の乾燥後、コンタクトホール56上の柱状スペーサ70を形成するスペーサエリアと、表示エリアの外周部を幅3mmで囲繞するエリアでは紫外線が遮光されるようなフォトマスクを介して露光量が300mJ/cm²となるように露光を行う。その後、pH=11.5のアルカリ性水溶液で現像し、200℃、60分焼成して、アレイ基板30上の表示エリア外周部の額縁状の遮光層(図示せず)と、表示エリア外周部の額縁状の遮光層(図示せず)と、表示エリア内のコンタクトホール56上に直径10μmの柱状スペーサ70を形成する。この時柱状スペーサ70は、下地のコンタクトホール56の影響を受け、その頂上70aが窪んだ形状となる。

【0019】 このようにして出来上がったアレイ基板3 0と、共通電極62を形成した対向基板60に、それぞ れ配向膜57、63を形成するためのポリイミド溶剤で あるAL-1051 (日本合成ゴム (株) 製) を均一に 塗布する。この時、柱状スペーサ70により表面に凹凸 が形成されるアレイ基板30にあっては、ポリイミド溶 削塗布直後は図2(a)に示すように柱状スペーサ70 の凹凸に沿ってポリイミド溶剤71が均一に塗布されて いるが、時間の経過に伴い全体を平坦化するよう柱状ス ペーサ70側面のポリイミド溶剤71が下に引っ張られ る。但し、柱状スペーサ70項上70aに塗布されたポ リイミド溶剤71は、図2(b)に示すように頂上70 aに形成された窪みに溜りそこにとどまる。従って柱状 スペーサ70の麓に落ちるポリイミド溶剤71が少なく なり、図2(c)に示すように焼成後アレイ基板30表 面の表示領域にあっては、配向膜57の膜厚はほぼ均一 に形成される。

【0020】この後アレイ基板30及び対向基板60をラビング処理し、エボキシ系の熱硬化樹脂から成る接着剤XN-215(三井東圧化学(株)製)を用いて貼合わせ、柱状スペーサ70にて均一に保持される両基板30、60間の間隙に液晶組成物50であるZLI-4792(E.メルク社製)を注入し、注入口を紫外線硬化樹脂で封止してカラー液晶表示素子20を完成する。

【0021】このカラー液晶表示素子20の両面に偏光板(図示せず)としてLLC2-9218S((株)サンリッツ社製)を貼り付け、駆動を行ったところ、柱状スペーサ周辺に表示むらを発生すること無く高品位の表示を得られた。

【0022】このように構成すれば、アレイ基板30に形成される凹凸状の柱状スペーサ70の上からポリイミド溶剤71を塗布しても、柱状スペーサ70項上70aに塗布されたポリイミド溶剤71は裾野に流れる事無く、頂上70aに形成される窪みにとどまるので、配向膜57は柱状スペーサ70の裾野にて膜厚ムラを生じる事無くほぼ均一の膜厚を得られ、ひいては膜厚むらによる表示むらを生じる事無くカラー液晶表示素子の表示品位を向上出来る。しかも柱状スペーサ70項上の窪みは、柱状スペーサ70を、アレイ基板30のコンタクトホール56上にてコンタクトホール56より径が大きく成るようパターン形成するのみで、きわめて容易に形成出来る。

【0023】次に本発明の第2の実施の形態を図3及び図4を参照して説明する。本実施の形態は、アレイ基板に形成されるコンタクトホールの直径に比し柱状スペーサの直径が小さく、コンタクトホール内に柱状スペーサを形成したものであり、他は第1の実施の形態と同一である事から同一部分については同一符号を付しその説明を省略する。

【0024】即ち本実施の形態のカラー液晶表示素子21では、層間絶縁層47上のカラーフィルタ層72に直径が6μmのコンタクトホール73をパターン形成し、更にカラーフィルタ層72上にITOからなる画素電極74を形成後、コンタクトホール73内に直径5μmの黒色樹脂からなる柱状スペーサ76を形成するものである。これによりコンタクトホール73内で柱状スペーサ76の麓には溝77が形成される。

【0025】このように周囲に溝77が形成される柱状スペーサ76を有するアレイ基板78にポリイミド溶剤71を均一に塗布すと、塗布直後は図4(a)に示すように柱状スペーサ76の凹凸に沿ってポリイミド溶剤71が均一に塗布されているが、時間と共に全体を平坦化するよう柱状スペーサ76表面のポリイミド溶剤71は下に引っ張られる。但し、柱状スペーサ76表面から下に垂れたポリイミド溶剤71は、図4(b)に示すよう柱状スペーサ76周囲の溝77に溜り周辺に流れ出す事50無くそこにとどまる。従って図4(c)に示すように焼

成後アレイ基板78表面の表示領域にあっては、配向膜57の膜厚はほぼ均一に形成される。

【0026】このように均一な配向膜57を有するアレイ基板78をラビング処理し、対向基板60と貼合わせ、液晶組成物50を注入してカラー液晶表示素子21を完成し、駆動を行ったところ、柱状スペーサ76周辺に表示むらを発生する無く高品位の表示を得られた。

【0027】このように構成すれば、アレイ基板78に形成される凹凸状の柱状スペーサ76の上からボリイミド溶剤71を塗布しても、柱状スペーサ76表面から落ちたボリイミド溶剤71は柱状スペーサ76周囲の溝77に溜りその周辺に流れ出す事が無いので、配向膜57は柱状スペーサ76の周辺にて膜厚ムラを生じる事無くはぼ均一の膜厚を得られ、ひいては膜厚むらによる表示むらを生じる事無くカラー液晶表示素子21の表示品位を向上出来る。しかも柱状スペーサ76周囲の溝77は、アレイ基板78のコンタクトホール73より径の小さい柱状スペーサ76をコンタクトホール73内に形成するのみで、きわめて容易に形成出来る。

【0028】次に本発明の第3の実施の形態を図5乃至 20 図7を参照して説明する。本実施の形態は、感光性樹脂 中に含まれる不純物成分が配向膜に吸着するのを防止す るため、柱状スペーサ形成後オーバーコート層を介し配 向膜を塗布するものである。尚、第1の実施の形態と同 一部分については同一符号を付しその説明を省略する。 【0029】即ち本実施の形態のカラー液晶表示素子2 2を構成するアレイ基板80は、層間絶縁層47上のカ ラーフィルタ層82に、上方に成膜される画素電極83 をコンタクト電極に接続するためコンタクトホール84 及び柱状スペーサ86が形成されるスペーサエリアとそ 30 の周囲を幅10μmづつ確保した凹状エリア87が形成 され、凹状エリア87内には柱状スペーサ86が形成さ れ、凹状エリア87内で柱状スペーサ86の麓の周囲に は溝88が形成されている。カラーフィルタ層82上に はオーバーコート層99を介し画素電極83が形成さ れ、その表面に配向膜90が塗布されている。

【0030】次にアレイ基板80の製造方法について述べる。層間絶縁層47形成後、続いてカラーフィルタ層82を形成する際、赤色の顔料を分散させた感光性レジストCR-2000(富士ハントテクノロジ(株)製)をスピンナーにて全面塗布し、90℃、10分の乾燥後、赤色の着色層を形成する部分のみに紫外線を照射し、(7μm×15μm)のスペーサエリアとその外周部(幅10μm)をカバーする凹状エリア87、及び(15μm×15μm)のコンタクトホール84エリアを遮光するフォトマスクを介し、露光量が200mJ/cm²となるように露光を行う。

【0031】次に、水酸化カリウム(KOH)1wt% 水溶液で20秒間現像を行い、200℃で60分焼成し て赤色の着色層82aを形成する。同様にフォトリソグ 50

ラフィ技術により緑色(G)の顔料を分散させた感光性レジストCG-2000(富士ハントテクノロジ(株)製)及び青色(B)の顔料を分散させた感光性レジストCB-2000(富士ハントテクノロジ(株)製)を必要部分に配置し、緑、青の着色層82bを設け、凹状エリア87及びコンタクトホール84を有するカラーフィルタ層82を形成する。

8

【0032】更に、感光性の黒色樹脂をスピンナーを用いて塗布し、90℃、10分の乾燥後、(7μm×15μm)のスペーサエリアと、表示エリアの外周部を幅3mmで囲繞するエリアでは紫外線が遮光されるようなフォトマスクを介して露光量が300mJ/cm²となるように露光を行う。次いでpH=11.5のアルカリ性水溶液で現像し、200℃、60分焼成して、アレイ基板80上の表示エリア外周部の額縁状の遮光層(図示せず)と、表示エリア内の柱状スペーサ86とを同時に黒色樹脂にて形成する。この時凹状エリア87内で柱状スペーサ86の麓の周囲には溝88が形成される。

【0033】さらに、感光性の透明樹脂をスピンナーを 用いて均一に塗布し、90℃、10分の乾燥後、(25  $\mu$ m×25 $\mu$ m)-のコンタクトホール84エリアが紫外 線が遮光されるようなフォトマスクを介して、露光量が 300mJ/cm² となるように露光を行いオーバーコ ート層99を形成する。この均一に塗布された透明樹脂 は、時間の経過に従い柱状スペーサ86表面から液垂れ し柱状スペーサ86周囲に落ちるが、柱状スペーサ86 周囲には溝88が形成されており、図6に示すように透 明樹脂はこの溝88に溜り周辺に流れ出す事無くそこに。 とどまりアレイ基板80表面の表示領域にあっては、オ ーバーコート層99の膜厚はほぼ均一に形成される。そ の後、スパッタリングによりITOを膜厚約0.1μm 成膜し、フォトリソグラフィにより所定の形状にパター ン形成してコンタクトホール84を介しコンタクト電極 48と接続する画素電極83を形成する。

【0034】このようにして出来上がったアレイ基板8 0と対向基板60に、それぞれ配向膜90、63を形成 するためのポリイミド溶剤であるAL-1051(日本 合成ゴム(株)製)を均一に塗布する。この時アレイ基 板80にあっては、時間の経過に従いポリイミド溶剤が 40 柱状スペーサ86表面から下に落ちるが、図7に示すよ うに柱状スペーサ86周囲の溝88の残された部分に溜 り周辺に流れ出す事無くそこにとどまる。従って焼成後 アレイ基板80表面の表示領域にあっては、配向膜90 の膜厚はほぼ均一に形成される。

【0035】このように均一なオーバーコート層99及び配向膜90を有するアレイ基板80をラビング処理し、対向基板60と貼合わせ、液晶組成物50を注入してカラー液晶表示素子22を完成し、駆動を行ったところ、柱状スペーサ86周辺に表示むらを発生する無く高品位の表示を得られた。

【0036】このように構成すれば、配向膜90は、オ ーバーコート層99を介し柱状スペーサ86上に成膜さ れており、黒色樹脂からなる柱状スペーサ86の不純物 成分が配向膜90に吸着する事が無く、これが原因の表 示ムラや焼き付きを防止出来表示品位の向上を図れる。 又、柱状スペーサ86が形成されるアレイ基板80に透 明樹脂及びポリイミド溶剤を塗布しても、柱状スペーサ 86表面から落ちた透明樹脂及びポリイミド溶剤は柱状 スペーサ86周囲の溝88に溜りその周辺に流れ出す事 が無いので、オーバーコート層99及び配向膜90は柱 10 状スペーサ86の周辺にて膜厚ムラを生じる事無くほぼ 均一の膜厚を得られ、ひいては膜厚むらによる表示むら を生じる事無くカラー液晶表示素子22の表示品位を向 上出来る。

【0037】次に本発明の第4の実施の形態を図8乃至 図10を参照して説明する。本実施の形態は、カラーフ ィルタ層に用いる着色層を積層して柱状スペーサを形成 したものであり、他は第3の実施の形態と同一であるこ とから同一部分については同一符号を付しその説明を省 略する。

【0038】即ち本実施の形態のカラー液晶表示素子2-3では、アレイ基板100に有機樹脂絶縁膜からなる赤 (R)、緑(G)、青(B)の3原色の着色層101 a、101b、101cにてカラーフィルタ層101を 形成する際、凹状エリア102内のスペーサエリアに順 次各着色層を積層して柱状スペーサ103を形成するも のである。

【0039】具体的には、先ず赤(R)の顔料を分散さ せた感光性レジストを、全面塗布し乾燥後、スペーサエ リアの外周部 (幅10μm) 104及び (15μm×1 5μm) のコンタクトホール106エリアを遮光するフ ォトマスクを介し、赤(R)の着色層を残そうとするエ リア及び  $(7\mu m \times 15\mu m)$  のスペーサエリアに露光 量が200mJ/cm²となるように紫外線の露光を行 う。これにより、赤色の着色層101aと同時にスペー サエリアに柱状スペーサ103の赤色層101aが形成 される。同様にフォトリソグラフィ技術により緑

(G)、青(B)の顔料を分散させた感光性レジストに て、緑、青の着色層101bを形成すると同時にスペー サエリアに柱状スペーサ103の緑色層101b、青色 40 層101cを順次形成する。これにより凹状エリア10 2内で柱状スペーサ103の麓の周囲には溝107が形 成される。尚、アレイ基板100上の表示エリア外周部 の額縁状の遮光層(図示せず)は、黒色樹脂にて形成す る。

【0040】この後赤色層、緑色層、青色層が積層され て成る柱状スペーサ103を有する上にオーバーコート 層108を形成するために感光性の透明樹脂を塗布する と、時間の経過に従い透明樹脂は柱状スペーサ103表 面から液垂れし周囲に落ちるが、図9に示すように周辺 50 するフォトマスクを用いてフォトリソグラフィにより順

に流れ出す事無く柱状スペーサ103周囲に設けられる 溝107に溜りそこにとどまる。 更に画素電極105を 形成後ポリイミド溶剤を塗布する際も、時間の経過に従 い柱状スペーサ103表面から下に落ちたポリイミド溶 剤は、図10に示すように周辺に流れ出す事無く柱状ス ペーサ103周囲の溝107の残された部分に溜りそこ にとどまる。従ってアレイ基板100に成膜されるオー バーコート層108及び配向膜110の膜厚は、表示領 域にてほぼ均一とされる。

10

【0041】このように均一なオーバーコート層108 及び配向膜110を有するアレイ基板100をラビング 処理し、対向基板60と貼合わせ、液晶組成物50を注 入してカラー液晶表示素子23を完成し、 駆動を行った ところ、第3の実施の形態と同様柱状スペーサ103周 辺に表示むらを発生する無く高品位の表示を得られた。 【0042】このように構成すれば、配向膜110は、 オーバーコート層108を介し赤、緑、青の顔料を分散 させた感光性レジストを積層して成る柱状スペーサ10 3上に成膜されており、柱状スペーサ103の不純物成 分が配向膜110に吸着する事により生じる表示ムラや 焼き付きを防止出来表示品位の向上を図れる。又柱状ス ペーサ103が形成されるアレイ基板100に透明樹脂 及びポリイミド溶剤を塗布しても、柱状スペーサ103 表面から落ちた透明樹脂及びポリイミド溶剤は柱状スペ ーサ103周囲の溝107に溜りその周辺に流れ出す事 が無いので、オーバーコート層108及び配向膜110 は柱状スペーサ103の周辺にて膜厚ムラを生じる事無 くほぼ均一の膜厚を得られ、ひいては膜厚むらによる表 示むらを生じる事無くカラー液晶表示素子23の表示品 位を向上出来る。

【0043】次に本発明の第5の実施の形態を図11乃 至図13を参照して説明する。本実施の形態は、カラー フィルタ層形成時に凹状エリアを形成する事無く、カラ ーフィルタ層上に柱状スペーサを形成し、更にオーバー コート層形成後に柱状スペーサ外周にてオーバーコート 層に窪みをパーターン形成するものであり、他は第3の 実施の形態と同一であることから同一部分については同 一符号を付しその説明を省略する。

【0044】本実施の形態のカラー液晶表示素子24で は、アレイ基板112に有機樹脂絶縁膜からなる赤 (R)、緑(G)、青(B)の3原色からなるカラーフ ィルタ層113上に柱状スペーサ114が形成され、そ の上に柱状スペーサ114周囲に溝116を有するオー バーコート層117が設けられる。 オーバーコート層1 17上には画素電極118が形成され、その表面に配向 膜120が塗布されている。

【0045】具体的には、赤(R)、緑(G)、青 (B)の顔料を分散させた感光性レジストを、(15 µ m×15µm) のコンタクトホール121エリアを遮光

次ストライプ状にパターン形成し、カラーフィルタ層1 13を形成する。次いでフォトリソグラフィ技術により (7μm×15μm)のスペーサエリアに黒色樹脂から なる (7μm×15μm) の柱状スペーサ114を形成 後、オーバーコート層117を形成する感光性の透明樹 脂を塗布し乾燥する。この時透明樹脂が塗布後時間の経 過に従い柱状スペーサ114表面から液垂れし周囲に落 ちることから乾燥時オーバーコート層117は図12に 点線で示すようになだらかな山形となっている。

11

【0046】この後スペーサエリアの外周部(幅10µ 10 m) 122及びコンタクトホール121エリアを遮光す るフォトマスクを用いフォトリソグラフィ技術により、 図12に示すようにオーバーコート層117にコンタク トホール121を形成すると同時に柱状スペーサ114 周囲に溝116をパターン形成する。更に画素電極11 8を形成後ポリイミド溶剤を塗布するが、この時、時間 の経過に従い柱状スペーサ114表面から下に落ちたポ リイミド溶剤は、図13に示すように周辺に流れ出す事 無く柱状スペーサ114周囲の溝116に溜りそこにと どまる。従ってオーバーコート層117はそのパターン 20 端部で、やや膜厚がムラに成るものの、配向膜1-20 は、アレイ基板112の表示領域にてほぼ均一とされ る。

【0047】このようなオーバーコート層117及び配 向膜120を有するアレイ基板112をラビング処理 し、対向基板60と貼合わせ、液晶組成物50を注入し てカラー液晶表示素子24を完成し、駆動を行ったとこ ろ、第3の実施の形態と同様柱状スペーサ114周辺に 表示むらを発生する無く高品位の表示を得られた。

【0048】このように構成すれば、配向膜120は、 オーバーコート層117を介し柱状スペーサ114上に 成膜されており、柱状スペーサ114の不純物成分が配 向膜120に吸着する事により生じる表示ムラや焼き付 きを防止出来表示品位の向上を図れる。又柱状スペーサ 114が形成されるアレイ基板112にオーバーコート 層117形成後にポリイミド溶剤を塗布しても、柱状ス ペーサ114表面から落ちたポリイミド溶剤は柱状スペ ーサ114周囲にパターン形成される溝116に溜りそ の周辺に流れ出す事が無いので、配向膜120は柱状ス ペーサ114の周辺にて膜厚ムラを生じる事無くほぼ均 40 一の膜厚を得られ、ひいては膜厚むらによる表示むらを 生じる事無くカラー液晶表示素子24の表示品位を向上 出来る。

【0049】次に本発明の第6の実施の形態を図14乃 至図16を参照して説明する。本実施の形態は、カラー フィルタ層に用いる着色層を積層して柱状スペーサを形 成したものであり、他は第5の実施の形態と同一である ことから同一部分については同一符号を付しその説明を 省略する。

は、アレイ基板124に有機樹脂絶縁膜からなる赤 (R)、緑(G)、青(B)の3原色からなるカラーフ ィルタ層126を形成する際、スペーサエリアに順次各 着色層126a、126b、126cを積層して柱状ス ペーサ127を形成する。その上に柱状スペーサ127 周囲に溝128を有するオーバーコート層130を設 け、オーバーコート層130上に画素電極131を形成 し、その表面に配向膜132が塗布されている。

12

【0051】具体的には、赤(R)、緑(G)、青 (B)の顔料を分散させた感光性レジストを、(15µ  $m \times 15 \mu m$ ) のコンタクトホール133エリア及び (7μm×15μm) のスペーサエリアを遮光するフォ トマスクを用いてフォトリソグラフィにより順次パター ン形成し、ストライプ状のカラーフィルタ層126及び 赤色層、緑色層、青色層が積層されて成る柱状スペーサ 127を形成する。オーバーコート層130を形成する 感光性の透明樹脂を塗布し乾燥する。この時透明樹脂が 塗布後時間の経過に従い柱状スペーサ127表面から液 垂れし周囲に落ちることから乾燥時オーバーコート層1 30は図15に点線で示すようになだらかな山形となっ

【0052】この後スペーサエリアの外周部(幅10μ m) 136及びコンタクトホール133エリアを遮光す るフォトマスクを用いフォトリソグラフィ技術により、 図15に示すようにオーバーコート層130にコンタク トホール133を形成すると同時に柱状スペーサ127 周囲に溝128をパターン形成する。更に画素電極13 1を形成後ポリイミド溶剤を塗布するが、この時、時間 の経過に従い柱状スペーサ127表面から下に落ちたポ リイミド溶剤は、図16に示すように周辺に流れ出す事 無く柱状スペーサ127周囲の溝128に溜りそこにと どまる。 従ってオーバーコート層130はそのパターン 端部で、やや膜厚がムラに成るものの、配向膜132 は、アレイ基板124の表示領域にてほぼ均一とされ る。

【0053】このようなオーバーコート層130及び配 向膜132を有するアレイ基板124をラビング処理 し、対向基板60と貼合わせ、液晶組成物50を注入し てカラー液晶表示素子27を完成し、駆動を行ったとこ ろ、第5の実施の形態と同様柱状スペーサ127周辺に 表示むらを発生する無く高品位の表示を得られた。

【0054】このように構成すれば、配向膜132は、 オーバーコート層130を介し柱状スペーサ127上に 成膜されており、柱状スペーサ127の不純物成分が配 向膜132に吸着する事により生じる表示ムラや焼き付 きを防止出来表示品位の向上を図れる。又柱状スペーサ 127が形成されるアレイ基板124にオーバーコート 層130形成後にポリイミド溶剤を塗布しても、柱状ス ペーサ127表面から落ちたポリイミド溶剤は柱状スペ 【0050】本実施の形態のカラー液晶表示素子27で 50 ーサ127周囲にパターン形成される溝128に溜りそ

13

の周辺に流れ出す事が無いので、配向膜132は柱状スペーサ127の周辺にて膜厚ムラを生じる事無くほぼ均一の膜厚を得られ、ひいては膜厚むらによる表示むらを生じる事無くカラー液晶表示素子27の表示品位を向上出来る。

【0055】尚本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、その趣旨を変えない範囲での変更は可能であって、例えば柱状スペーサの材質や構造、配向膜やオーバーコート層等の被膜の種類や材質は任意である。また柱状スペーサや、溝の形成方法等も限定されず、例えば 10 第1の実施の形態において、柱状スペーサの下地が平坦で有ることから、頂上が平坦な柱状スペーサを形成後、頂上部分を再度露光したりあるいはエッチング等により頂上を削成して、頂上に窪みを形成する等しても良い。【0056】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、基板に柱状スペーサを形成し、その頂上に溶液を溜める窪みを設けあるいは柱状スペーサの周囲に溝を設けているので、柱状スペーサ上から基板に配向膜やオーバーコート層等の被膜の塗布時、溶剤が柱状スペーサの周辺に流 20 れ出す事無く、柱状スペーサ頂上の窪みや周囲の溝にとどめることが出来、柱状スペーサ周囲において被膜の膜厚ムラを防止出来、膜厚ムラを原因とする表示ムラを解消し高品位な液晶表示素子を得ることができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の液晶表示素子を示す一部概略断面図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態の配向膜の製造工程を示し(a)はそのポリイミド溶剤塗布時、(b)はそのポリイミド溶剤塗布から時間経過後、(c)はそのポ 30 リイミド溶剤焼成後を示す概略説明図である。

【図3】本発明の第2の実施の形態の液晶表示素子を示す一部概略断面図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態の配向膜の製造工程を示し(a)はそのポリイミド溶剤塗布時、(b)はそのポリイミド溶剤塗布から時間経過後、(c)はそのポリイミド溶剤焼成後を示す概略説明図である。

【図5】本発明の第3の実施の形態の液晶表示素子を示す一部概略断面図である。

【図6】本発明の第3の実施の形態オーバーコート層塗 40

布時を示す概略説明図である。

【図7】本発明の第3の実施の配向膜塗布時を示す概略 説明図である。

【図8】本発明の第4の実施の形態の液晶表示素子を示す一部概略断面図である。

【図9】本発明の第4の実施の形態オーバーコート層塗 布時を示す概略説明図である。

【図10】本発明の第4の実施の配向膜塗布時を示す概略説明図である。

10 【図11】本発明の第5の実施の形態の液晶表示素子を 示す一部概略断面図である。

【図12】本発明の第5の実施の形態オーバーコート層 塗布時を示す概略説明図である。

【図13】本発明の第5の実施の配向膜塗布時を示す概略説明図である。

【図14】本発明の第6の実施の形態の液晶表示素子を示す一部概略断面図である。

【図15】本発明の第6の実施の形態オーバーコート層 塗布時を示す概略説明図である。

) 【図16】本発明の第6の実施の配向膜塗布時を示す概略説明図である。

【図17】従来の配向膜の製造工程を示し(a)はそのポリイミド溶剤塗布時、(b)はそのポリイミド溶剤塗布から時間経過後、(c)はそのポリイミド溶剤焼成後を示す概略説明図である。

【符号の説明】

20…カラー液晶表示素子

30…アレイ基板

31…スイッチング素子

30 36…半導体層

47…層間絶縁膜

48…コンタクト電極

50…液晶組成物

52…カラーフィルタ層

54…画素電極

56…コンタクトホール

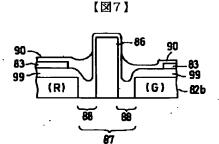
57…配向膜

60…対向基板

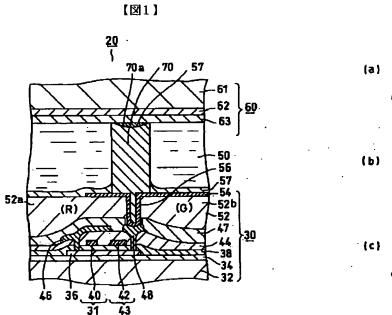
63…配向膜

83 82a (R) 99 83 62b

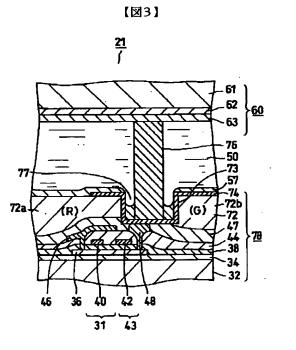
【図6】

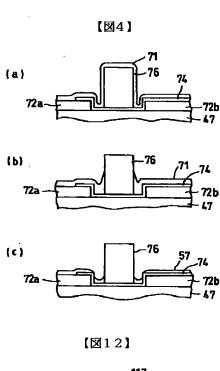


【図2】



20:カラー液温表示業子 30:アレイ蒸収 31:スイッチング素子 36:半導体層 47:層間急接度 48:エンタンル電信 50:液品組成像 52:カラーフィルタ服 54:国業電信 56:コンタントホール 57,63:配向膜 60:対白基板



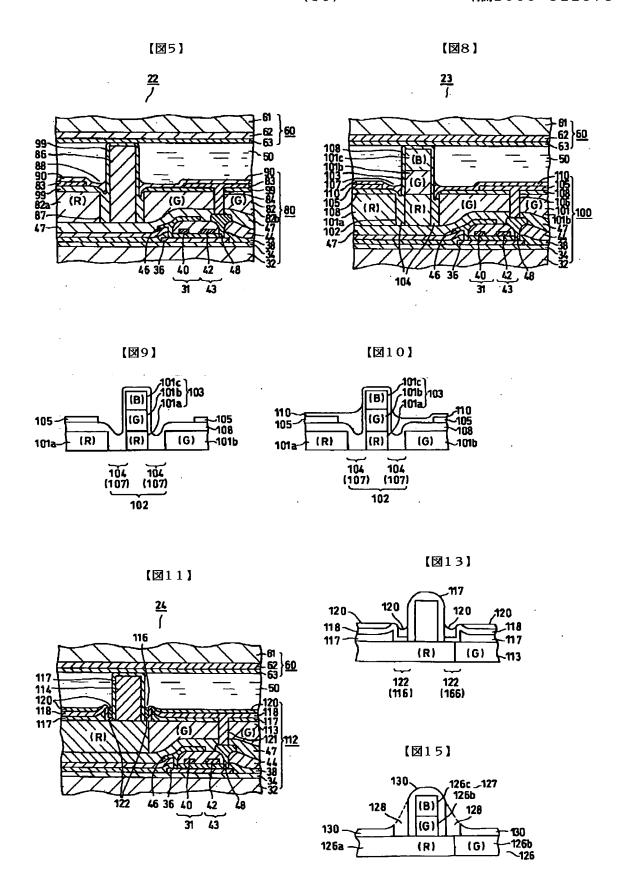


(R)

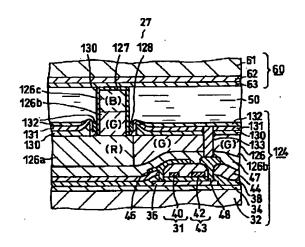
122

(G)

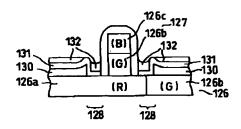
122



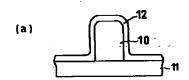
【図14】



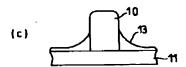
【図16】



【図17】







# フロントページの続き

(72)発明者 二ノ宮 希佐子

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番2号 株式 会社東芝深谷電子工場内

(72)発明者 倉内 昭一

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番2号 株式

会社東芝深谷電子工場内

Fターム(参考) 2H089 HA15 JA11 LA09 LA14 LA16

LA19 LA20 MA04X NA05

NA14 NA24 NA25 NA40 NA45

NA48 NA56 NA60 PA02 QA12

QA13 QA14 SA01 TA02 TA04

TA12

5C094 AA03 AA42 AA43 AA47 AA48

BA03 BA43 CA19 CA24 DA07

DA13 EA04 EA07 EC03 EC04

ED03 ED15 FA01 FA02 FA10

GB01 GB10